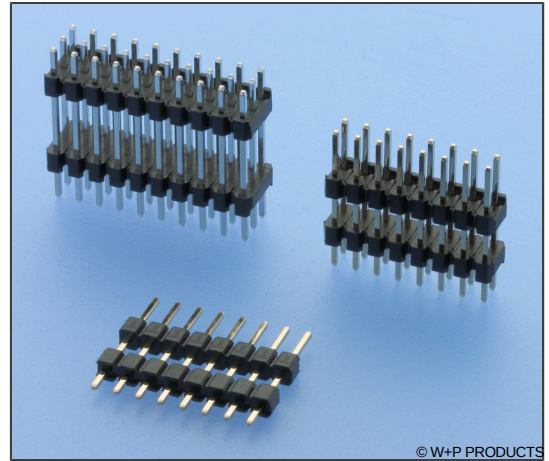


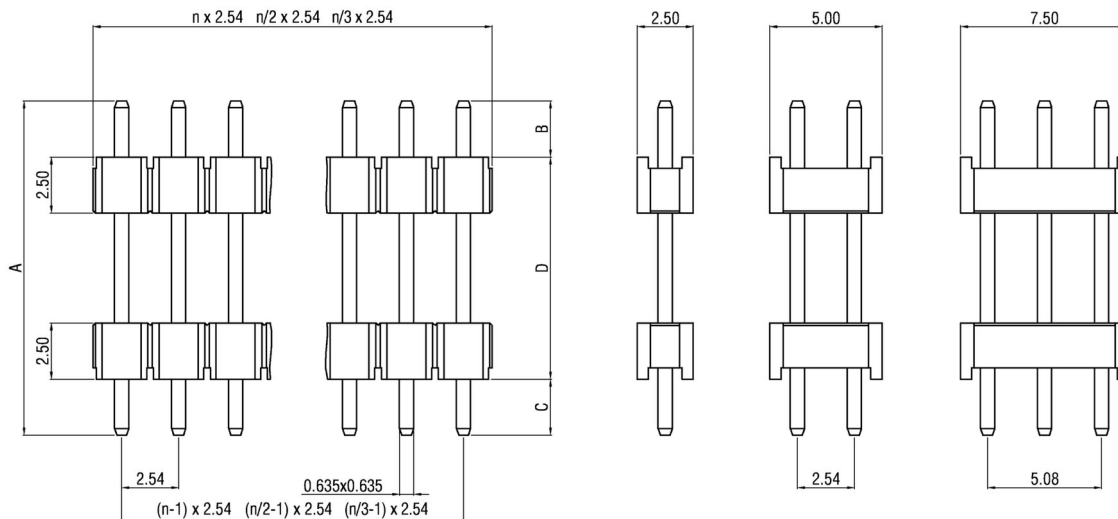
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c <i>RoHS Exemptions 6a-I / 6c</i>	keine <i>none</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Withstanding Voltage</i>	1 kV DC <i>1 kV DC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC <i>250 V AC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C <i>-40 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*

949

Gestanzte/geprägte Kontakte
Stamped/formed contacts
949 Einreihig
Single row
950 Zweireihig
Double row
951 Dreireihig
Triple row

Dimensions*

19

16 A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm
17 A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm
18 A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm
19 A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm
20 A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm
21 A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm
22 A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm
23 A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm
24 A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm
25 A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm
26 A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm
A/B/C/D Gesamtlänge & Wunschnmaße
Total length & Dimensions

Contacts*

010

001-050 Einreihig
Single row
004-100 Zweireihig
Double row
006-120 Dreireihig
Triple row

Plating*

00

00 Au flash
110 Sel. Au 0,25μm / flash
130 Sel. Au 0,75μm / flash
50 Sn
66 Sel. Au flash / Sn
610 Sel. Au 0,25μm / Sn
80 Sel. Au 0,75μm / Sn
Au flash <= 0,1μm
Au flash <= 0,1μm

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die
Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm,
7,62mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage. Bestellseite
"Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter Techn.
Informationen.

B, C, D variable acc. to custom specifications. We will
manufacture pin headers in the desired number of contacts.
5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches on request.
Order page "Customer-specific Pin Configurations" in
Technical Information.

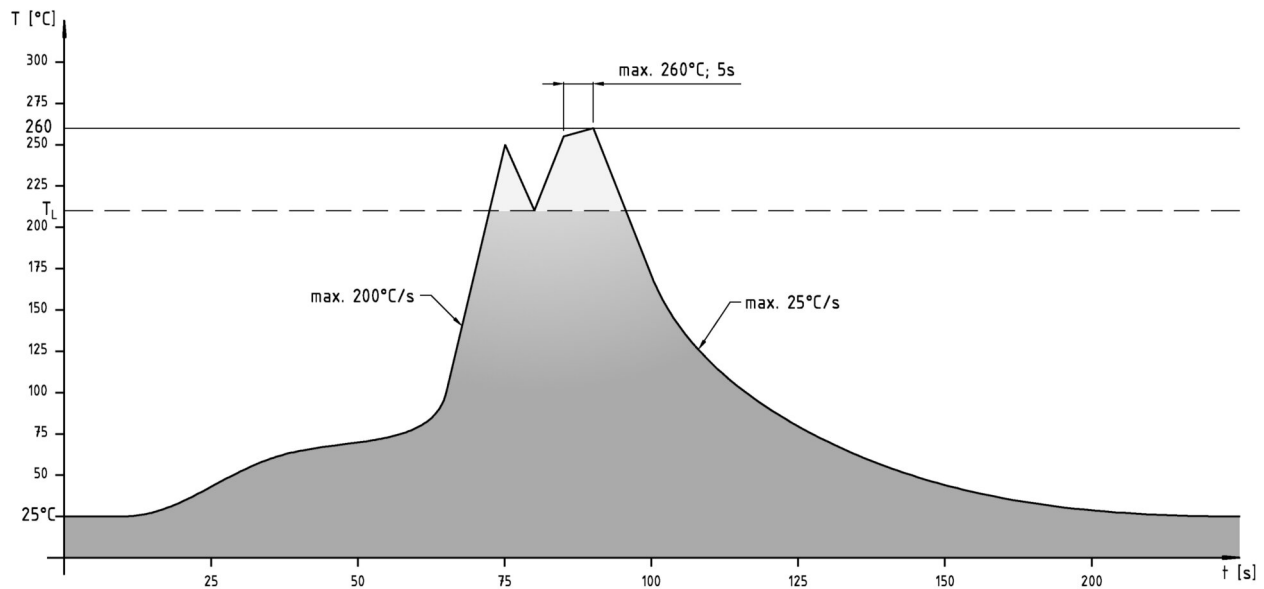
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

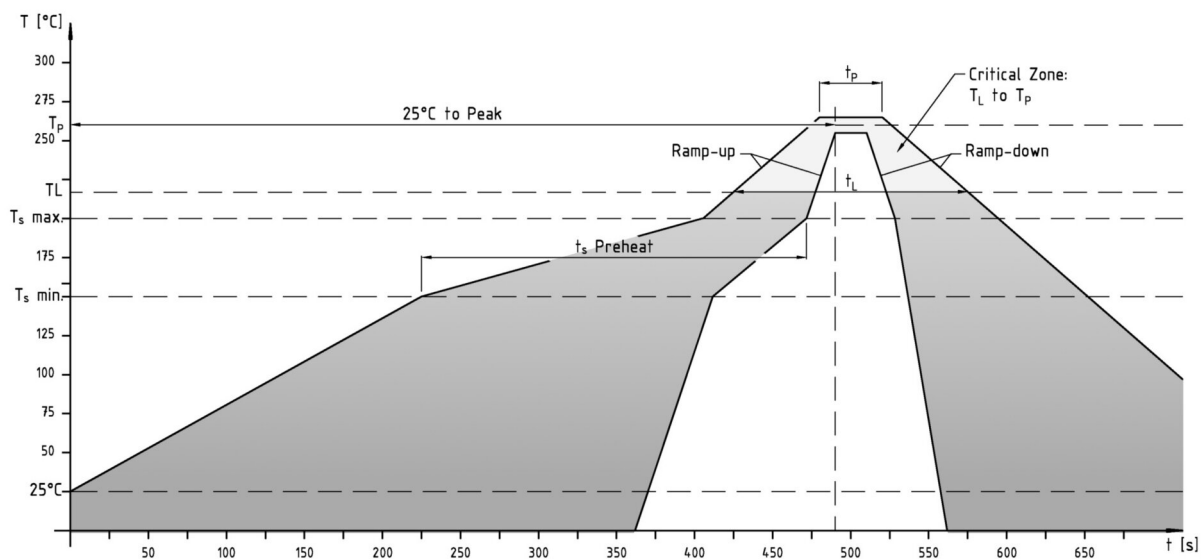
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

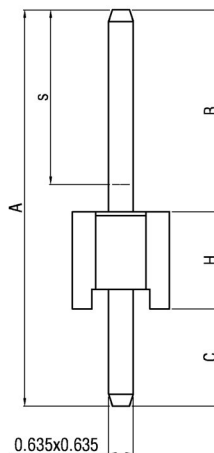
Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25 °C - Peak Temp. T_P	max. 8min



Gerade Stiftheiten / Straight Pin Headers

A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
B : Länge Steckseite / Mating Side Length
C : Länge Lötseite / Solder Side Length
H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

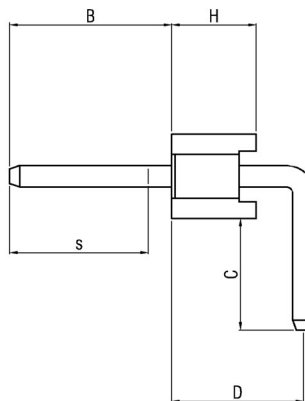
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



Gewinkelte Stiftheiten / Right-Angled Pin Headers

B : Länge Steckseite / Mating Side Length
C : Länge Lötseite / Solder Side Length
D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



PCB Layouts

